## <sup>®</sup>公開特許公報(A)

昭58—90722

H 01 L 21/20 21/263 27/12

識別記号

庁内整理番号

7739-5F

8122-5F

砂公開 昭和58年(1983) 5 月30日

発明の数 審査請求 未請求

(全 2 頁)

### ❸半導体装置

创特

昭56-191112

後田 昭56(1981)11月25日

仍発 明 者 佐藤真一

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地三菱電

究所内

①出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2

機株式会社エル・エス・アイ研

番3号

砂代 理 人 弁理士 葛野信一

外1名

# BEST AVAILABLE COPY

妈

発明の名称

半導体装置

特件構収の範囲

下地層上に部分的に単数晶層を有し。この単結 爲層に兵子を形成して成る半導体装置において、 上記単結晶層が深さ方向に対して傾きを有してい ることを特徴とする半導体装置。

発明の詳細な説明

この発明は、下地層上に部分的に単結晶層を有 する半導体装置に関するものである。

蚊丘、多時品シリコン等に対し、 レーザビーム と所望の部分に級射して単結晶シリコン化するこ とが悩んに行なわれている。その結果、名子を三 と元的に 何層も複み上げることが 可能となつてき こ朳であるが、この場合、従来は、レーザピーム : 所望の部分の上部から一定エネルギーで垂直に 3.射し、必要な部分にわたつてピームを検方向に : キャンさせながら、一定面積の単結晶化を行つ 〕 きた。この場合の単結晶の成長は、 差板(下地

)に対して垂直になつている。ところが、火服の デパイスについてみると、単結品層の断面形状は ・デバイスの用途によつては一定角度をもつた場 合の方が優れた特性を示す場合があり、必要に応 じて角度をつけた単結晶層が有益となる。

本免明はこのような点に進ぶてなされたもので 単結晶層が深さ方向に対して似きを有した半導 体技量を提供するものである。

**第1図は従来の単結贔屓の形成方法とそれによ** つて得られた構造を示すもので、シリコン姜板口 上にシリコン酸化農(2)を形成し、その全面に多糖 **島 シリコン膜 (3)を形成した素子の上から垂直にレ** ーザピームUOを照射しながら水平矢印方向にスキ ヤンし〔第1図44〕、所蔵の部分の多結晶シリコ ン膜(3)を単結晶(3')化する〔第1図(3)。

その後、上記単結晶シリコン(3)の上に不純物 等を拡散して、低抗あるいはトランジスタ等の乗 子を形成する。これをくり返すことによって、三 次元的にデバイスを挟み上げていくことができる。 この方法の場合、ビーム収は温度に当てられる

\_117\_\_

特局昭58~90722(2)

ため、単結晶化も基板に対し こに成長してい く。なお、四は反射ヒーム。 (30)は吸収ヒームで ある。

罪 2 凶は本発明構造を実現するための方法とそ れによつて得られた単結晶の構造を示す断面図で 、従来の方法と同じ素子の上から、必要な部分に ついては科目にピーム四を照射する。この場合、 入射角によつて単結晶の成長角度が決定され、必 要なデバイス形状、用途、特性に応じて入射角度 を設定してやれば良い。例えば低抗体を形成する 場合、下地基板のシリコン酸化長(2)との浮遊容量 を出来るだけ少くしたい時は、出来るだけ底の面 横を小さくする必要がある駅で、その場合は、入 射角を出来るだけ残くし、シリコン酸化額(2)と単 結晶層(3)との機能面積を小さくする。又、素子 の絶縁破壊耐圧あるいは分離間のリーク電旅等は 単結晶の形成角度プロファイルによつて微妙に形 響されるので、デバイス特性の必要に応じて最適 プロファイルを設定すれば良い。

以上のように本発明によれば、単結蟲層の断面

プロファイルを垂直以外の任意の角度をもたせる ようにしたので、従来得られなかつた 性面にお ける改善をなし得ることが可能となる。

なお本発明は、レーザピームによつて多結晶シ リコンをアニールし、単結晶化する場合の構造に ついて述べたが、部分的にレーザを照射して所望 の部分の物質を化学的、物理的に性質を変えて用 いる場合の構造についても適用できることはもち ろんである。

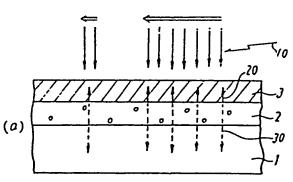
#### 図面の簡単な説明。

第 1 図は従来技術を示す断面図、第 2 図は本発 明の一実施例を示す断面図である。

図において、(1)はレリコン基板、(2)はレリコン **敀化額、(3)は多略品レリコン膜。(3')は単結品レリ** コン膜である。

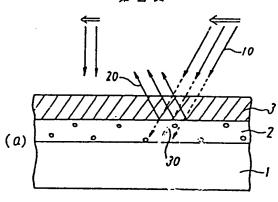
なお、図中同一符号は同一叉は相当部分を示す。

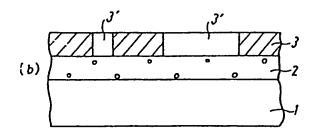
### 第 1 図



AVAILABLE COPY

第2四





(<del>B</del>)

